

3EC-M2S-VLP

- ・ ロープロファイル電解銅箔であり、サブトラでのファインパターン形成に最適です。
Low profile copper foil, suitable for fine etching in the subtractive process.
- ・ また、高張力であるため、薄箔でも取扱いが用意です。
High tensile strength, easy to handle thin foil.
- ・ 最薄で7 μ mまでラインナップしております。
From 7 μ m, we line up.

用途/Application

- ・ 半導体パッケージ基板
/Semiconductor Package

構成/Composition



生産拠点/Production Site

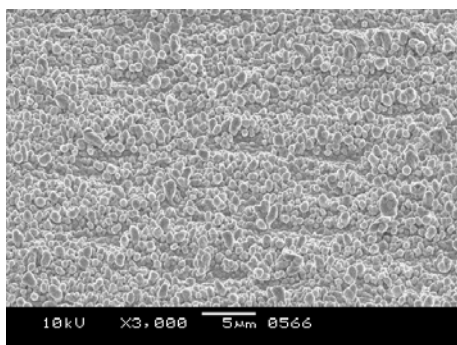
- ・ 日本 / Japan

代表的特性値/Representive date

	μ m	Area weight (g/m ²)	Laminate side Rz(μ m)	Tensile Strength (N/mm ²)	Elongation (%)	Peel Strength (kg/cm) ^{@FR-4}
3EC-M2S-VLP	9	80	1.8	500	4.0	0.6
	12	107	1.8	500	5.0	0.7
	18	153	1.8	500	8.0	0.8

※表中の数値は代表値です。保証値ではありません。
This is representative date, not guarantee.

ラミ面/Laminate side



レジ面 resist side

